

●三星ダイヤモンド

脆性材料の加工装置

量産想定にリニユーアル

三星ダイヤモンド工業(株)
(MDI、大阪府摂津市香
露園32-12、☎072-6
48-5000)は、セラ
ミックや化合物半導体など

の脆性材料加工用のスクラ
イブ装置とブレイク装置を
リニユーアルし、顧客に提
案している。インライン化
を想定して拡張性を高める

とともに、長寿命ツールを
採用して量産プロセスに適
用しやすい装置とした。す
でに数件の商談を進めてお
り、5、6月から順次出荷
を予定している。

同社はガラスの切断加工
技術をコアとし、FPD用
ガラス基板加工装置を主力
とする。コア技術の応用展
開の一環として、スクライ

ピング&ブレイキング(S
nB)加工を脆性材料に提
案している。以前からサフ
アイア基板やLTC基板
の加工に装置を提供した実
績はあったが、19年から新
規領域として本格展開を開
始した。

SnB加工は非常に高精
度で、一般的なダイサーと
比べて約10倍もの高速加工

を実現し、削りしろがない
という特徴がある。また、
ドライプロセスであるため
研削液を処理する必要もな
い。

スクライブ装置の「LS
シリーズ」、ブレイク装置
の「HBシリーズ」をライ
ンアップしており、セラミ
ック新素材や化合物半導体
材料の加工に採用されてい

る。ただ、これまでは両装
置ともにセミオートで、イ
ンライン化するには改造が
必要であるなど量産適用に
制約があった。

今回、両装置を「II」と
してリニユーアルした。拡
張性を高めてインライン化
しやすくし、新たに開発し
た加工ツールを採用した。
量産適用を想定し、長寿命
化を図っている。電子部品
や化合物半導体市場向けに
販売し、早期に売上高20億
円規模の事業に成長を目指
す。FPD分野に次ぐ柱と
して育成したい考えだ。